

“第四届 ChinaDA 学术研讨会”即将召开

浙江省半导体行业协会 EDA 专业委员会

浙江大学信息学部主办的“第四届 ChinaDA 学术研讨会”将于 2020 年 5 月 23 日和 5 月 30 日以线上会议形式展开。浙江省半导体行业协会 EDA 专业委员会(以下简称浙半协 EDA 专委会)等三家科研组织将协助举办。会议主题是“芯片 EDA 和电路/架构设计技术”。

本次研讨会主要由主题报告、前沿论坛、DAC' 20 前瞻、青年学者分享和行业新锐视角五个部分组成。演讲嘉宾有韩银和、陈怡然、潘纲、汪玉、史弋宇、曾志宇、张政、黄乐天等 20 多位专家学者，将发表精彩纷呈的学术报告和专题演讲。

浙半协 EDA 专委会的两家会员单位杭州行芯科技有限公司董事长兼 CEO 贺青与杭州法动科技有限公司执行董事赵鹏将在会上分别作《Achieving chip-package-system multiphysics reliability》与《用于高频高速电路电磁仿真的 EDA 软件》的专题演讲。

届时，将邀请众多技术大咖和国内外顶尖学者参与本次研讨，参会人员将就芯片设计交叉领域的最新研究进展和发展趋势开展深入的交流和探讨。

ChinaDA 是由国内集成电路设计、电子设计自动化、测试等学科青年学者自发组织的学术共同体。其使命是推动国内集成电路设计、自动化设计、测试，以及与之交叉的计算机体系结构和工艺器件等领域研究，为青年人搭建同行交流平台，提高本学科在国内科研界的地位。鼓励从事芯片设计的青年学者在组织中多发声，多曝光，扩大学术影响力，让年轻学者、年轻企业有更广阔的社交平台，增加产学研交流机会。

本次研讨会执行主席由卓成（浙江大学）和罗国杰（浙江省北大信息技术高等研究院）两位专家共同担纲。

参加本次研讨会注册网址和二维码：

jinshuju.net/f/4Tk1YV

